

中信证券股份有限公司
关于广东鼎泰高科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之
上市保荐书

保荐机构（主承销商）



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

二〇二二年三月

目 录

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| 目 录..... | 1 |
| 声 明..... | 2 |
| 第一节 本次证券发行基本情况 | 3 |
| 一、发行人基本情况 | 3 |
| 二、本次发行情况 | 20 |
| 三、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况 | 21 |
| 四、保荐人与发行人的关联关系 | 23 |
| 第二节 保荐人承诺事项 | 25 |
| 第三节 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论 | 26 |
| 一、本次发行履行了必要的决策程序 | 26 |
| 二、是否符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件 | 26 |
| 三、保荐机构结论 | 27 |
| 四、对公司持续督导期间的工作安排 | 27 |

声 明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”或“保荐机构”）及具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《广东鼎泰高科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）》中相同的含义）

第一节 本次证券发行基本情况

一、发行人基本情况

(一) 发行人基本信息

| | |
|-----------------|---|
| 公司名称: | 广东鼎泰高技术股份有限公司 |
| 英文名称: | Guangdong Dtech Technology Co., Ltd. |
| 注册资本: | 36,000 万元 |
| 法定代表人: | 王馨 |
| 有限公司成立日期: | 2013 年 8 月 8 日 |
| 整体变更设立日期: | 2020 年 9 月 14 日 |
| 公司住所: | 广东省东莞市厚街镇赤岭工业一环路 12 号之一 2 号楼 102 室 |
| 邮政编码: | 523940 |
| 电话号码: | 0769-89207168 |
| 传真号码: | 0769-89277198 |
| 互联网网址: | http://www.dtechs.cn |
| 电子信箱: | BOD@dtechs.cn |
| 负责信息披露和投资者关系部门: | 董事会办公室 |
| 董事会办公室负责人: | 周文英 |
| 董事会办公室电话号码: | 0769-89207612 |

(二) 发行人的主营业务

公司是一家专业为 PCB、数控精密机件等领域的企业提供工具、材料、装备的一体化解决方案，具有自主研发和创新能力的高新技术企业。PCB 为各类电子系统提供元器件的装配支撑和电气连接的功能，被广泛应用于电子产品制造领域，属于电子信息行业重要组成部分。PCB 产业发展水平可在一定程度上反映一个国家或地区电子产业的整体发展速度与技术水平。在整个电子产业链中，PCB 属于上游产业，而公司主要产品钻针、铣刀则属于 PCB 加工制造专用的耗材。

公司自成立之日起，便致力于微钻、铣刀及其他刀具等产品设计制造，积累了丰富的生产工艺和质量管理经验，具备全系列的研究设计、制造能力，为广大客户提供全方位的产品解决方案。公司目前是国内 PCB 刀具生产规模最大的企

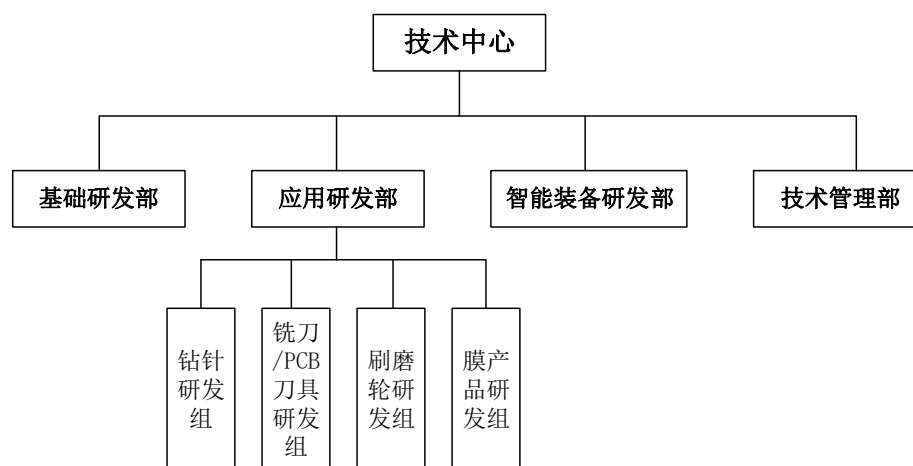
业之一，与健鼎科技、方正科技、华通电脑、瀚宇博德、胜宏科技、深南电路、景旺电子、崇达技术等国内外知名 PCB 生产厂商建立了长期稳定的合作关系。

（三）发行人的核心技术及研发水平

1、研发机构设置及人员构成

（1）研发机构设置

为确保研究开发活动的顺利进行，公司形成以技术中心为核心平台的研发体系。公司技术中心下设基础研发部、应用研发部、智能装备研发部和技术管理部。公司研发体系为持续推出新产品、不断优化产品生产及提升产品质量提供了坚实的技术保障，能够为客户提供精准的产品技术服务。技术中心的架构设置如下：



经过多年技术积累，公司根据行业特点、公司战略及技术研发团队构成情况，逐步建立了契合公司发展战略、面向行业主要发展方向的分工明确的研发组织结构。公司通过了质量管理体系等多项认证，并制定了严密的研发管理制度和绩效考核制度，储备了一批经验丰富的研发人才，形成了完善的研发体系。

（2）人员构成

发行人积极倡导全体员工树立创新意识，支持员工积极参与行业技术交流，不定期地组织研发技术人员与客户、供应商、经销商进行积极的交流和互访，深入产品上下游，获取更多的反馈意见、建议，把握产品需求，从而拓宽创新思维，实时了解市场需求动态，以研发出更迎合市场需求的产品。

同时，发行人也高度重视相关人才的引进和培育。发行人通过与高校、科研机构等在技术研发、应用等领域的深度合作，加强对员工的培训和技术交流，全

方位提高员工素质。同时，发行人也会根据市场的变化以及产业发展战略调整，积极地完善技术人员结构，以满足公司快速发展的技术研发需求。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司研发人员共 256 人，占员工总数的 10.83%；公司共有核心技术人员 3 人，占员工总数的 0.13%。公司核心技术人员的具体情况如下：

| 序号 | 核心技术人员 | 职务 | 研发实力和贡献 |
|----|--------|----------------|--|
| 1 | 陈汉泉 | 研发部副总监 | 深圳大学工程硕士学位，机械工程师。2013年加入鼎泰高科，现任公司研发部副总监，所参与科研项目“新型钢柄PCB用精密微型钻头”获得深圳市龙岗区科技创新奖，参与科研项目“印刷电路板用插接精密微型钻头研发及产业化”获得深圳市科学技术奖；主持并参与“一种具有耐氧化硬质润滑涂层的PCB钻头”、“一种钻孔及去除突破口毛刺的组合刀具”等20余项专利的研发及申请，在PCB刀具产品研发、技术创新方面有丰富的经验 |
| 2 | 李政 | 智能装备研发部项目经理 | 大专学历，国家中级钳工，高级电工，国家中级机械工程师，自1999年起从事设备研发工作，对精密设备制造、自动化设备改良具有丰富的经验；2011年加入鼎泰高科，现任智能装备研发部项目经理，负责研发PCB刀具相关设备；2018年获评东莞市“首席技师”荣誉，2019年获评东莞市十大“莞邑工匠”荣誉，2019年度主导研发成功的四站式微钻加工机项目，被列入“东莞市首台（套）重点技术装备推广应用指导目录”；主持并参与“一种四站式铣刀机”、“一种五站式铣刀加工机”等20余项专利的研发及申请，对国内刀具行业的发展具有重大贡献 |
| 3 | 徐莹 | 应用研发部刷磨轮研发组副经理 | 西安科技大学化学工程与工艺专业，本科学历，初级工程师，2017年加入鼎泰高科，现任应用研发部刷磨轮研发组副经理，负责公司刷磨轮产品的研发工作；主持或参与“一种用于印刷电路板表面处理的陶瓷磨具”、“一种有机结合剂磨具及其制备方法”、“一种不织布磨刷发泡用减压吸胶装置”、“一种不织布磨刷”等10余项专利的研发及申请，主持开发具有行业竞争性的高端PCB研磨产品陶瓷刷磨轮，参与攻克环氧常温化学发泡技术等 |

2018 年初，公司其他核心人员为核心技术人员陈汉泉、李政和徐莹。公司由于业务拓展需求于 2018 年 3 月引进专业人员李辉担任核心技术人员。2021 年 6 月李辉因个人原因辞去公司职务，不再参与公司研发工作。目前公司核心技术人员为 3 名，分别为陈汉泉、李政、徐莹。报告期内，公司核心技术人员未发生重大变化，对公司的生产经营未造成不利影响。

(3) 在研项目情况

截至本上市保荐书签署日，发行人在研项目及进展情况如下表所示：

| 序号 | 项目名称 | 用途 | 研发进度 | 主要研发人员 | 研发目标 | 技术水平 |
|----|-------------------------|--|---------|------------|---|--|
| 1 | 钻针智能仓储库技术的研究 | 全自动化、智能化钻针仓储系统，能够实现自动检测、自动分拣、自动存储、自动研磨、自动配针等，根据钻针全长与二维码信息及钻孔质量要求评估与管控单支钻针研磨次数及生命周期 | 市场推广阶段 | 熊晖琪、胡会彬 | 目前整个行业全部处于人工处理状态，浪费空间、盘点困难、管控繁琐、耗费人力、出错率高，使用该设备将大幅提升自动化水平，提高效率 | 钻头智能仓储该模式极大的提升了空间利用率和存取作业效率，减人增效，尤其是信息系统拓展非常方便，是市场应用极广的新选择。完成配针全自动流程串联作业 |
| 2 | 变齿宽的铣刀的研发 | 该项目主要用于 PCB 线路板成型加工中铣刀寿命的提升，特别适用于中高 TG 板材的切削加工，较少客户的换刀时间，提升产品质量稳定 | 市场推广阶段 | 陈汉泉、杨肖 | 该项目主要是研发一款新型铣刀，该铣刀较现有产品的抗磨损、排尘、断刀寿命等性能均有提升，满足市场需求 | 新型的刀具结构设计、断屑槽几何图形设计，行业领先 |
| 3 | 一种超长径比钻针的开发 | 一种超长径比钻针的开发，长径比 ≥ 30 倍，高刚性，排屑空间大，使用寿命长的双刃单槽钻针，该产品的开发主要用于高多层印制板，其主要应用于覆铜孔直径比 ≥ 22 倍的超深孔的加工 | 市场推广阶段 | 陈汉泉、王崇、谭芒飞 | 超长径比微钻单次可加工 PCB 板片数上升，PCB 钻孔工序效率可提升 20%-33%；该长径比钻针采用双刃单槽结构，该结构相对于常规双刃双槽钻针，存在高刚性优点，有效降低 PCB 钻孔过程中断针率，避免 PCB 板材报废；该长径比钻针采用双刃单槽结构，钻头排屑性能良好，解决了加工时铜箔切屑缠绕的问题 | 设计超长径比双刃单槽钻头几何结构图形；解决超长径比微钻加工过程中的异常点，制定工艺路线、选定加工设备、检测设备等；解决高叠层板微钻容易断针问题；解决高叠层板容易出现缠丝，分层，和孔口毛刺等品质问题 |
| 4 | 一种 2.00mm 柄径 IC 载板钻头的开发 | 5G 和物联网有望引领全球第四次硅含量提升周期，拉动对上游 IC 载板等材料的需求增长。可以实现多引脚、高密度化、更加小型化的 BGA (FC-BGA) 及 CSP 封装基板的市场将持续高速地增长，且对钻针在使用 | 小批量试产阶段 | 陈汉泉、王崇、谭芒飞 | 开发一种 2.0mm 柄径 IC 载板钻针，以满足现有设备与封装基板钻针不匹配现象，同时改善客户端出现的断针、孔壁不光滑、孔位精度偏低等现象 | 也随着 PCB 市场的不断开发，板材类型的不断变化，需求更高的品质和性能来满足高端客户的需求，设计合理的结构，满足其钻孔高精密性 |

| 序号 | 项目名称 | 用途 | 研发进度 | 主要研发人员 | 研发目标 | 技术水平 |
|----|-----------------|--|---------|----------------|---|--|
| | | 时的要求也越来越高，因此研制一种2.0mm柄径IC载板的微型钻针来实现该领域载板的微孔加工 | | | | |
| 5 | 一种自动在线检测设备的研制 | 利用自动检测装置，对已开槽研磨加工产品的刀面判定、心厚、芯斜度、螺纹角度、边刀槽长等参数量测，及量测后参数的调整，达到减少调机时间、检测难度，提高开槽加工后产品的品质及良率效率 | 小批量试产阶段 | 李政、史德豪、黄春雷、张亿中 | 利用高精度光学测量头，对已加工产品的刀面，芯厚，芯斜度，螺纹角度等进行自动量测，自动分档等动作，提高检测的精度及检测的效率 | 采用立式检测结构，有效解决在检测过程中由于局部检测导致的检测误判问题；检测高度通过升降机构和PLC控制，满足不同检测位置需求；检测时具有不良品分档功能和对不良品自动区分功能，以适应不同钻针直径与刀面检测位置的生产及控制；配带自动入出料机构，提高生产效率 |
| 6 | 一种ID大钻粗精磨四站机的研制 | 主要研究内容是设计ID大钻粗精磨一体机结构，提高生产效率及生产品质；ID大钻刃粗磨、刃精磨效率提升；研究自动上下料机构，130支载料治具可自动周转；适用范围3.2~6.5毫米钻针生产；研发适用于改良设备的高速电主轴，用于ID大钻生产 | 小批量试产阶段 | 李政、易成圆 | 研究自动上下料机构，130支载料治具可自动周转；适用范围3.2-6.5mm钻针生产；研发适用于改设备的高速高功率电主轴 | 整机采用四个工作站的分割角度定位精度；针对于不同直径焊接产品的自动上下料功能开发；研发精密电主轴替代皮带传动的机械主轴 |
| 7 | 3D曲面手机保护膜的研究 | 该项目主要针对曲面手机的出货及使用保护，利用特殊的叠层设计，面层具有高硬度高耐磨及优异的防指纹效果，中间层在UV光固化作用下具有优异的定型效果，底层与曲面玻璃具有优异的贴附性，对曲面玻璃具有优 | 小批量试产阶段 | 李东平 | 该项目旨在开发一种用于曲面玻璃的出货或者使用保护膜，目前市面上曲面保护的热弯玻璃成本高易碎裂且对屏下指纹辨识有影响，热弯PET易回弹，贴合容易翘边，TPU则使 | 该技术生产的曲面手机保护膜，解决了目前市面上使用的热弯玻璃、热弯PET及TPU这些产品的不足，定型和贴合性好，使用体验佳，高温高湿后不翘边 |

| 序号 | 项目名称 | 用途 | 研发进度 | 主要研发人员 | 研发目标 | 技术水平 |
|----|----------|--|---------|---------|--|---|
| | | 异的保护效果 | | | 用体验差，表面易刮伤。本项目利用特殊的叠层结构及中间自主研发的光固化定型层，可在 UV 光照时快速达到曲面定型的效果 | 不回弹，屏下指纹辨识灵敏度高，边缘不会出现碎裂问题。公司已针对该技术申请专利，属于国内领先水平 |
| 8 | 防窥膜的研究 | 该项目研究一种防隐私泄露的保护膜，不仅具有优异的光学透过率且具备稳定的可视角度，用于手机，平板，电脑等显示器表面，实现防止隐私泄露的效果 | 小批量试产阶段 | 赵永真，李东平 | 开发一种可用于手机，平板，电脑，等显示器表面防止隐私泄露的保护膜，可视角度为 28-35 度，无漏光点，无结构线等外观问题 | 该技术生产的防窥膜，防窥角度为 28-35 度，透过率大于 62%，无漏光点结构线，高温高湿稳定性高 |
| 9 | 高精密部品件加工 | 开发高精度、高转速、大扭矩的电主轴配置于钻针、铣刀等刀具加工设备，应用于刀具生产加工 | 小批量试产阶段 | 李政、王康康 | 通过对设备稳定性和电主轴性能的分析，提升电主轴的性能有利于提升设备的精度和生产良率，通过电主轴内制化降低刀具加工设备成本，提升钻针，铣刀等产品的竞争力 | 电主轴的核心是精磨加工和装配，公司有多年的精密零件加工经验和精密机械装配经验，对零件的加工有充分的把握，具备该项目研发的所有配套人员和应用场景 |
| 10 | 中大钻钻针研磨机 | 研究中大钻研磨机构，自动上下料机构并利用视觉检测实现全自动研磨，提升效率，及检测精度、提升品质。 | 小批量试产阶段 | 黄春雷、张亿中 | 该设备用于硬质合金钻头刃面全自动研磨和检测，解决 PCB 行业硬质合金钻头生产厂商钻针研磨耗人耗时、产品质量不稳定等问题，设计此全自动中大钻研磨设备替代人工研磨。设备主要功能包括：八大图像及全长检测、刀面清洁、环深校正、机械手上下料、输送带式收料、不良品回收等 | 随着 5G 市场的不断开发，对更高品质钻针的需求提升，本项目通过设计微米级精度机构并开发微米级检测，提高钻孔产品精密度，达到了国内领先水平 |

| 序号 | 项目名称 | 用途 | 研发进度 | 主要研发人员 | 研发目标 | 技术水平 |
|----|-----------------|--|------|-------------|---|--|
| 11 | 钻针涂层治具及自动插针工艺开发 | 本项目旨在通过对钻针涂层载具的研究，开发可实现治具公转、自转及钻针自转的多重转动治具，提升钻针涂层时的均匀性，改善涂层性能；同时基于新治具开发涂层工艺中的自动插针机，替换人工插针作业，极大提升插针效率和节省人工成本。 | 研发阶段 | 彭子阳、周志宇、谢文荣 | 通过多重旋转涂层治具，消除涂层阴阳面现象，提升涂层均匀性，同时配套插针设备，实现钻针、铣刀在整个涂层流程中（来料清洗，钻针装载、钻针卸载、钻针检测、钻针入库、出货）的自动化插针作业。 | 新型治具实现治具公转、自转及钻针自转，解决了钻针涂层行业内真空涂层性能受阴阳面影响的问题，同时自动插针机实现了钻针自动插针，可替换行业目前大量的手工插针作业，实现钻针涂层性能及效率的大幅度提升，处于国内领先水平。 |
| 12 | 智能仓储物流智慧化提升 | 智能钻针仓储系统，实现钻针检测、分拣、存储、研磨、配针、退针的自动化作业，根据钻针二维码信息及钻孔质量要求评估与管控钻针的研次及生命周期，同时满足各单/专机间的物流输送。 | 样机阶段 | 熊晖琪、胡会彬 | 解决行业内现有作业模式下存在的管控难、浪费多、盘点乱及故障率高等痛点，提升作业效率，实现自动化作业，减人增效。 | 通过对产品二维码信息的管理，对整个工艺流程进行有效监控，引进高速仓储技术并整合业务逻辑，创新式的配针结构，完成自动化作业并解决客户相关痛点。 |

(4) 研发费用情况

报告期内，公司研发费用构成情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2021年1-6月 | | 2020年度 | | 2019年度 | | 2018年度 | |
|-----------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 直接投入费用 | 1,665.10 | 47.61% | 2,904.99 | 49.53% | 1,942.01 | 46.54% | 1,524.85 | 45.98% |
| 直接人工 | 1,529.73 | 43.74% | 2,496.03 | 42.56% | 1,927.29 | 46.19% | 1,480.86 | 44.65% |
| 折旧费 | 124.48 | 3.56% | 207.27 | 3.53% | 176.78 | 4.24% | 161.07 | 4.86% |
| 中介机构服务费 | 36.17 | 1.03% | 37.42 | 0.64% | 6.00 | 0.14% | 46.71 | 1.41% |
| 水电费 | 24.00 | 0.69% | 36.86 | 0.63% | 24.98 | 0.60% | 27.63 | 0.83% |
| 交通及差旅费 | 26.83 | 0.77% | 46.56 | 0.79% | 53.58 | 1.28% | 41.32 | 1.25% |
| 无形资产摊销 | 3.40 | 0.10% | 6.70 | 0.11% | 6.31 | 0.15% | 4.12 | 0.12% |
| 委外投入 | 44.98 | 1.29% | 57.50 | 0.98% | - | - | - | - |
| 其他 | 42.67 | 1.22% | 71.28 | 1.22% | 35.93 | 0.86% | 29.90 | 0.90% |
| 合计 | 3,497.35 | 100.00% | 5,864.61 | 100.00% | 4,172.88 | 100.00% | 3,316.47 | 100.00% |

报告期各期，公司研发费用分别为 3,316.47 万元、4,172.88 万元、5,864.61 万元和 3,497.35 万元，研发费用率分别为 6.27%、5.96%、6.06%和 6.08%。公司的研发费用主要为直接材料和直接人工投入。公司高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提升，通过构建科学合理的研发体系，使公司研发方向能够始终紧随行业前沿步伐，又能紧密贴合客户实际需求，为公司未来业务迅速发展奠定了良好基础。

2、主要研发成果及研发情况

公司在长期的生产经营过程中，自主研发了多项专利、非专利技术，这些技术是公司在工艺、制程能力方面的关键核心技术和共性技术，在 PCB 刀具、数控刀具等产品的生产过程中起到降低制造成本、提高产品良率、优化生产流程和工艺技术参数、丰富产品结构等作用，可以更好地满足客户对刀具产品品质提升等各方面需求。公司核心技术主要情况列表如下：

| 序号 | 技术名称 | 关键技术与功能特点 | 应用阶段 | 成果转化情况 |
|----|-----------------------|--|------|--|
| 1 | 无卤阻燃型陶瓷刷开发 | 一种无卤阻燃型陶瓷刷的开发，专用于 PCB 无卤制程，并通过引入反应型无卤素阻燃环氧树脂，与添加型无卤阻燃剂协同作用，实现 UL94-V0 级别阻燃 | 量产 | 发明专利：一种有机陶瓷磨刷及其制备方法（ZL201911231813.0） |
| 2 | 液体法陶瓷技术研究 | 一种陶瓷刷的全新制备工艺，使用液体发泡的方式制备有机陶瓷研磨块，该方法由于提前将矿砂通过分散盘高速分散在液体树脂中，矿砂基本是单颗粒状态分散，研磨效果可以达到日本进口的效果，并且该方法相对热压法成型简单，生产效率更高 | 量产 | - |
| 3 | 微型合金刀具四工位精密研磨技术研究 | 该设备主要用于 PCB 微型钻针的加工成型，采用新型的四工位机构，一次装夹完成整个产品的加工，通过数控系统控制实现自动化作业，具有加工精度高、生产效率高和稳定性强等特点 | 量产 | 实用新型专利：一种四站式铣刀机（ZL201920969675.5）；一种刀具自动研磨设备（ZL201820987117.7） |
| 4 | 微型合金刀具加工技术研究及配套数控系统开发 | 基于数控控制系统的框架协议，根据所制刀具的种类编写对应的加工运行程序，通过参数的调整满足各种刀具的快速切换 | 量产 | 非专利技术 |
| 5 | 偏光片磨边刀具的研发 | 应用于显示面板的偏光片磨边加工，克服超长刃对刀具的冲击，在结构上采用芯径锥度的设计；沟槽及后角的独特设计，使得加工光洁度高，不能出现立纹、毛刺等品质瑕疵 | 量产 | 非专利技术 |
| 6 | 一种高精度四站式开槽磨尖设备的研制 | 主要研究内容是设计一体机结构，完成多工序整合，提高生产效率；微钻开槽，开刃，刃面研磨工序整合；研究自动上下料机构，500 支载料治具可自动周转；适用范围 0.05-0.4 毫米钻针生产；研发适用于改设备的高速电主轴 | 量产 | 实用新型专利：一种用于可变式角度修整夹持治具（ZL201921955809.4） |
| 7 | 尼龙无纺布基热叠合研磨片技术开发 | 基于该技术平台，生产一种寿命长、研磨效率高、塞孔率低的磨刷产品。该磨刷可替代 PCB 磨板制程中传统的尼龙针刷、火山灰毛刷、砂带等，提升研磨效率。基于技术平台可以衍生出高切削不织布磨刷、发泡不织布磨刷、低塞孔不织布磨刷等相关产品 | 量产 | 实用新型专利：一种不织布磨刷（ZL201821578565.8） |

| 序号 | 技术名称 | 关键技术与功能特点 | 应用阶段 | 成果转化情况 |
|----|------------------------------|--|------|--|
| 8 | 紫外激光技术的研发与应用 | 紫外激光打标是冷加工，加工过程为“光蚀”效应，“冷加工”具有很高负荷能量的（紫外）光子，能够打断材料或周围的介质内的化学键，致使材料发生非热过程的破坏 | 量产 | 发明专利：一种 FPC 全自动立体同轴光激光打标机（ZL201821824454.0） |
| 9 | 封装用高端细粒度陶瓷刷技术研究 | 该技术采用纯环保材料制备，不产生 VOC，生产过程对环境无影响。常规 PVA 研磨轮虽研磨效果极好，但是制备过程中需大量使用甲醛及盐酸等环境危害物。该技术推广后不仅可以打破 PCB 线路精抛材料的国外垄断现状，更能实现环境友好型作业标准 | 技术储备 | 非专利技术 |
| 10 | 一种 3.175mm 柄径 IC 封装基板钻针的开发研究 | 运用于 IC 封装载板的微孔加工。IC 载板目前仍垄断于日本、韩国和台湾，国内 PCB 厂商如深南电路等逐步进入，后期对 0.075-0.15mm 的超微细钻针的需求量将不断加大 | 技术储备 | 非专利技术 |
| 11 | 常温环氧发泡技术开发 | 常温发泡环氧是处于前沿的发泡技术，该技术具有较强的环境友好性，发泡过程中无需高温加热和额外添加有害的化学发泡剂，不产生 VOC 废气及废水。该技术主要用于改善现有产品性能，相对聚氨酯发泡，常温环氧发泡操作简单。环氧树脂本身刚性较强，使用环氧发泡体系设计磨刷，可解决研磨力不足的问题，也会进一步提升磨刷寿命 | 技术储备 | - |
| 12 | 一种粗精磨设备对磨工艺的开发 | 提供一种用于钻头刃部加工的装置和工艺，能够有效降低钻针粗磨时的断针几率，保证加工精度的稳定性及提升产品良率、效率，降低生产成本 | 量产 | 实用新型专利：一种用于 PCB 钻头刃部精磨的磨料机构（ZL201921955814.5） |
| 13 | 一种电阻焊把柄设备的研制 | 通过焊接工艺的要求，设计电阻焊把柄的尺寸及加工工艺；通过设备测试，选出电阻焊把柄加工的最优设备；通过耗材测试，选出加工良率高，效率高的车刀；通过 DOE 实验，制定电阻焊把柄加工工序的最优参数；焊接生产效率高、良率高 | 量产 | 实用新型专利：一种把柄长度自动识别分选装置（ZL201922437280.3） |
| 14 | 一种台阶磨设备的研制 | 提供一种用于钻头刃部粗磨的装置；能够自动修整粗磨砂轮、简单有效的实现待刃部粗磨钻针的自动下料及自动磨削、保证加工精度的稳定性及提升产品良率、效率，降低生产成本 | 量产 | 实用新型专利：一种用于 PCB 微型钻头的刃粗磨磨削夹持支撑装置（ZL201921957314.5） |

| 序号 | 技术名称 | 关键技术与功能特点 | 应用阶段 | 成果转化情况 |
|----|------------------------|---|------|--|
| 15 | 不塞孔高切削超细纤维磨刷开发 | 提供辅助研磨的不织布产品,用于 PCB 塞孔树脂去除后的表面整平,线路板层压后表面胶粒的去除,镀铜或钻孔后铜颗粒及毛刺的去除等,具有不堵塞线路板孔洞的特点。不塞孔磨刷开发,属于国内领先水平,成功量产后可使不织布产品更新换代,产品性能大幅度提升 | 技术储备 | 非专利技术 |
| 16 | 激光切割工艺技术研究及其装备开发 | 开发适用于陶瓷片打孔及划线、陶瓷线路板的精密切割成型的设备,可切割氧化铝陶瓷、氧化锆陶瓷、氮化铝陶瓷基板,在保证高精度、高效率、精确控制高能激光束,实现精密加工,属于国内领先水平 | 技术储备 | 非专利技术 |
| 17 | 微钻超硬、润滑 TiSi 系复合涂层技术研发 | 铣刀硬质涂层技术已经成熟,但微钻除了硬质的要求,对钻削过程的排屑顺畅性也有一定的要求,所以需要同时具备硬质与润滑功能 | 量产 | 实用新型专利:一种具有耐氧化硬质润滑涂层的 PCB 钻头 (ZL201820686792.6) |
| 18 | 应用于 PCB 钻针自动收料系统的开发 | 该系统主要用于微钻加工过程中,通过大型的集成控制,将生产中的产品自动抽检,检测完成后进行分类摆放,进一步的扩展可以用来连线控制机台的参数修改等功能 | 量产 | 非专利技术 |
| 19 | 基于图像处理的微钻自动化检测技术的研究 | 新型全自动微钻刃面检测装备,可以检测项目包括:外径、圆角、缺口、重叠、垂直分开、芯厚、偏心等,该设备刷新了常规仪器加人工听觉判定的检测模式,机电一体化程控检测,产品质检精准可靠,减轻员工劳动强度,为微钻生产企业大幅节省人力资源和生产成本 | 量产 | 非专利技术 |
| 20 | 加工铝基板用双刃钻尖型铣刀的研发 | 铝基板应用于高端 LED 照明上,起到良好的导热作用,但金属切削的难度对铣刀的要求越来越高,双刃钻尖型铣刀的需求量越来越大,针对市场需求,公司开发出相应产品 | 量产 | 非专利技术 |
| 21 | 弹性陶瓷刷产品开发 | 本研究提供一种弹性陶瓷研磨材料,专用于 PCB 制程中的塞孔树脂去除,表面整平等制程,通过特殊结构的树脂体系,赋予陶瓷块一定回弹性,在接触板面时降低研磨深度,避免了凹坑及磨痕的出现,同时还保留了无机陶瓷的固有特点,在去树脂能力上优于不织布磨刷,同时也不会出现塞孔问题 | 量产 | 发明专利:一种有机结合剂磨具及其制备方法 (ZL201811267364.0); 实用新型专利:一种用于印刷电路板表面处理的陶瓷磨具 (ZL201922153220.9) |

| 序号 | 技术名称 | 关键技术与功能特点 | 应用阶段 | 成果转化情况 |
|----|------------------------------------|---|------|---|
| 22 | 5G 手机前后盖保护复合材料的研究 | 防指纹高清/磨砂硬化膜适用于 3C 及光学屏幕保护领域。通过特殊硬化层精密涂布制造而成，硬化层具有硬度高、稳定性好、表面抗划伤能力强，水滴角高，防指纹效果好且钢丝绒摩擦后仍具有较好的防指纹效果，依客户需求可实现高清或者磨砂防指纹效果 | 量产 | 实用新型专利：一种 UV 膜固化机构及 UV 膜加工系统（ZL201822272927.7） |
| 23 | 亮光书写白膜的胶水配方及涂布技术研究[含哑光书写白膜的胶水配方研究] | 哑光书写膜适用于学校、家庭、会议、办公等各种需要同时满足书写及投影的场合。书写膜通过特殊硬化涂层精密涂布制造而成，并在硬化层表面做消光处理，具有机械强度高、稳定性好、表面抗划伤能力强，光泽度低，在满足消光的同时具有易于书写和擦拭，光泽度低等特点 | 量产 | 实用新型专利：一种含 PET 基材的书写膜（ZL201921188222.5）；一种哑光书写膜（ZL201921185020.5） |
| 24 | 高硬度耐磨光学膜的技术研究 | 高硬度耐磨光学膜适用于印刷、包装、3C 及光学屏幕保护领域。通过特殊硬化层精密涂布制造而成，硬化层不仅硬度高而且耐磨性好，具有机械强度高、稳定性好、表面抗划伤能力强，做成磨砂面指刮无痕，表面耐钢丝绒、羊毛毡摩擦性好 | 量产 | 实用新型专利：UV 灯聚光调节结构及涂布机（ZL201820165450.X） |
| 25 | 基于独立视觉系统定位的高效补强贴合技术研究 | 本研究提供单平台、双平台 2 种系列 FPC 补强贴合设备，设备基于高精度视觉定位系统，通过高速、高精度的运动控制机构，实现 FPC 板补强片的自动剥离、吸取、加温、贴合、重贴/漏贴检测及自动上下 FPC 板的高效、高精度、全流程自动作业 | 量产 | - |
| 26 | 通用大平台贴合技术研究 | 本研究提供大平台系列 FPC 补强贴合设备，设备基于高精度视觉定位系统，及高速、高精度的运动控制机构，可实现大尺寸 FPC 板补强片的自动剥离、吸取、加温、贴合、重贴/漏贴检测、及自动上下 FPC 板的全流程自动作业。同时也可通过机构配置，实现片状补强片的手动剥离、上料，再自动贴合的半自动作业，满足客户小批量，快速贴合的需求 | 量产 | 实用新型：一种剥料机构（ZL201921691473.5）；一种上下料机构（ZL202020659667.3）；一种板件自动贴料机（ZL201921691308.X） |

| 序号 | 技术名称 | 关键技术与功能特点 | 应用阶段 | 成果转化情况 |
|----|-------------------|---|------|--|
| 27 | 一种超细焊接棒料的工艺开发 | 该工艺的研究开发能够实现 0.8mm 钨钢棒料焊接，通过工艺开发、改善，提升焊接工序加工效率，实现高效率、高良率的批量化生产 | 量产 | 非专利技术 |
| 28 | 一种电阻焊接设备的研制 | 利用电流通过焊件及接触处产生的电阻热作为热源将已加工半成品的柄和钨钢进行局部加热，同时加压进行焊接的方法，提高焊接的强度及焊接的效率 | 量产 | 非专利技术 |
| 29 | 中大钻高孔粗钻针的开发 | 该钻针主要用于汽车板板材加工，改善孔壁粗糙不良，满足高孔粗要求 | 量产 | - |
| 30 | 真空等离子镀膜技术的应用及设备开发 | 本项目提供 PVD、CVD、Ta-C 三种真空涂层设备，分别通过物理气相沉积、化学气相沉积、磁过滤的方法使物质等离子化，通过对设备腔体真空度、电源输出、温场、气场、磁场、水冷系统等关键因素进行精准采集和控制，确保等离子沉积工艺的一致性和稳定性，满足市场对各种硬质涂层、金刚石涂层、类金刚石涂层日益增长的需求 | 量产 | 实用新型：一种涂层机的载料装置（ZL202021871617.8）；一种涂层机的真空加热装置（ZL202021871965.5）；一种带有液冷载台组件的真空涂层机构（ZL202021871802.7） |

公司核心技术产品为钻针、铣刀、刷磨轮、精密数控刀具、自动化设备等。报告期内，公司核心技术产品业务收入占营业收入比例超过 95%。

3、技术创新机制和安排

公司建立以客户需求为基础的研究开发理念，满足多样化消费需求。公司业务部门对国内外市场进行广泛的调研，深入了解行业动向及用户企业需求状况形成调研意见；公司技术中心根据业务部门的调研意见制定立项报告并协调生产部门完成产品的研发。

公司在引进专业人才的同时，与广东工业大学等高校开展产学研合作，增强公司技术能力和知识储备，持续保持公司在业内的技术竞争优势。公司重视现有研发人员的培养，有计划、有步骤地开展岗位技术培训，提高研发人员的研发水平。

公司加强对技术中心的建设与完善，优化资源配置，制定有效的研发运行及管理机制。公司建立研发项目管理制度，制定并完善开发人员绩效考核方案和奖励机制，从人员、制度上保证创新工作的开展。

(四) 发行人在报告期内的主要经营和财务数据及指标

| 项目 | 2021年1-6月/ 2021-06-30 | 2020年度/ 2020-12-31 | 2019年度/ 2019-12-31 | 2018年度/ 2018-12-31 |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 资产总额（万元） | 168,442.64 | 147,822.18 | 109,525.44 | 84,100.95 |
| 归属于母公司的所有者权益 （万元） | 79,309.31 | 68,196.82 | 47,221.98 | 36,239.76 |
| 资产负债率（母公司） | 39.35% | 36.70% | 20.00% | 11.79% |
| 营业收入（万元） | 57,565.14 | 96,730.37 | 70,029.54 | 52,929.86 |
| 净利润（万元） | 11,096.53 | 17,566.79 | 7,059.21 | 6,881.28 |
| 归属于母公司所有者的净利润（万 元） | 11,112.50 | 17,614.78 | 7,119.32 | 6,952.22 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司 所有者的净利润（万元） | 10,448.68 | 15,648.79 | 7,254.53 | 6,995.37 |
| 基本每股收益（元） | 0.31 | 0.49 | / | / |
| 稀释每股收益（元） | 0.31 | 0.49 | / | / |
| 加权平均净资产收益率 | 15.07% | 30.38% | 17.19% | 32.93% |
| 经营活动产生的现金流量净额（万 元） | 14,989.95 | 15,143.47 | 6,036.64 | -13,848.62 |
| 现金分红（万元） | - | - | - | - |

| 项目 | 2021年1-6月/ 2021-06-30 | 2020年度/ 2020-12-31 | 2019年度/ 2019-12-31 | 2018年度/ 2018-12-31 |
|-------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 研发投入占营业收入比例 | 6.08% | 6.06% | 5.96% | 6.27% |

（五）发行人的主要风险

1、原材料价格波动及供应风险

公司的钻针、铣刀等主要产品以钨钢作为主要原材料。一方面，公司采购的钨钢材料来源于境内外，且目前境外采购比例较高，材料价格受经济环境、政策环境、供求关系、汇率等因素的影响较大，若外部环境发生变化，原材料的价格会受到一定影响，进而导致公司生产成本发生相应波动，给公司的盈利水平带来不确定性，并且自2020年末起，钨和钴等原材料价格有所上升，如果未来原材料市场价格维持高位或持续上升，将可能对公司的生产经营造成一定的不利影响，根据敏感性分析，假设销售价格和其他因素不变，如主要原材料钨钢价格上涨5%-20%，2021年1-6月公司净利润将相应下降5.32%-21.28%；另一方面，虽然公司与主要供应商建立了稳定的合作关系，相关原材料市场供应充足，但如果主要供应商生产经营突发重大变化，或供货质量、时限未能满足公司要求，或与公司业务关系发生变化，将可能对公司的生产经营产生不利影响。虽然公司与部分主要客户的销售协议中约定了调价机制，但调价方式、调价范围等未作出具体安排，如公司在主要原材料价格大幅上涨时不能将风险向下游客户转移，公司经营业绩将受到不利影响。

2、市场竞争风险

目前PCB专用切削工具行业在法律法规及政策方面并无针对性准入门槛的规定，未来市场竞争将会愈加激烈。尽管下游优质的PCB厂商往往会选择供应量稳定、生产工艺成熟、产品质量稳定的供应商进行采购，而且一经确定通常不会轻易更换，但随着行业内竞争者的增加，若未来公司无法在生产工艺改进、人才引进方面持续投入，提升自身产品竞争力，满足下游厂商产品需求，将对公司产品市场地位造成一定的不利影响。

3、技术替代风险

PCB钻孔工艺主要分为机械钻孔和激光钻孔，发行人钻针产品属于机械钻孔工艺的耗材。机械钻孔所适用的板材类型、钻孔直径范围较广，几乎覆盖所有

PCB 钻孔领域，激光钻孔工艺虽亦应用于 PCB 领域，但目前主要在 0.15mm 以下直径的微孔领域配合机械钻孔进行钻孔加工，特别用在盲孔、埋孔加工。激光钻孔工艺存在钻机价格高昂且维修更换成本高、孔型不规则、烧蚀过程会导致 PCB 性能不稳定、无法对 5G 领域 PCB 的各类复合材料基材同时达到加工要求等劣势，导致激光钻孔的大批量应用受限，在短期内难以得到突破，不会大幅替代机械钻孔。公司目前立足已有技术，高度关注激光钻孔工艺技术的发展。如果公司未来无法在 PCB 钻孔工艺领域持续保持技术创新能力，或因技术升级迭代无法保持持续的技术先进性，公司将面临核心技术竞争力降低的风险。

4、寄售模式风险

公司对部分重大客户及战略客户采取寄售模式进行销售，报告期内公司直销中寄售模式产生的收入在主营业务收入中占比分别为 51.72%、57.12%、58.52% 和 58.65%。该模式下，公司根据客户需求进行生产，并将产品运送至客户仓库或客户指定的第三方物流仓库，在客户领用产品并对账后确认已领用产品收入。如果客户对已领用产品未及时与公司到账，则公司存在收入确认延迟的风险。

5、短期偿债能力风险

2018 年末、2019 年末、2020 年末和 2021 年 6 月末，公司的流动比率分别为 1.30、1.27、1.23 和 1.29，速动比率分别为 0.81、0.87、0.82 和 0.86，营运资金较为紧张。目前公司的业务正处于快速增长期，对营运资金的需求较大，若未来公司不能有效地拓宽融资渠道，将会面临短期偿债能力风险。

6、应收账款风险

报告期内，公司应收账款账面价值分别为 24,222.44 万元、31,475.37 万元、37,627.62 万元和 42,245.28 万元，占各期末总资产的比例分别为 28.80%、28.74%、25.45% 和 25.08%，占各期营业收入的比例分别为 45.76% 和 44.95%、38.90% 和 73.39%。由于公司业务规模扩大等因素，公司应收账款持续增长。如果市场竞争加剧或客户自身经营出现重大不利变化，将不利于公司应收账款的收回，对公司的资产质量和经营业绩产生不利影响。

7、部分租赁房产未取得权属证书风险

发行人及子公司的租赁房产主要用于铣刀及其他刀具、刷磨轮、自动化设备

等产品生产及办公、宿舍、仓储等用途，其中未取得权属证书的生产用途房产面积共计 42,108 平方米。若政策发生变化导致上述房产被强制拆除或因其他原因无法继续租赁，将对公司生产经营产生不利影响。

8、募集资金投资项目实施风险

本次募集资金计划用于 PCB 微型钻针生产基地建设项目、精密刀具类产品扩产项目、补充流动资金及偿还银行借款。以上项目是基于当前经济形势、市场环境、行业发展趋势及公司实际经营状况做出的。如果公司因自身管理能力不足，或者因市场环境发生不利变化、行业竞争加剧等原因，导致项目不能按照进度实施，或者实施后不能达到预期收益，将对公司经营计划的实现和持续发展产生不利影响。

二、本次发行情况

| | | | |
|------------|---|--------------|---------|
| 股票种类 | 人民币普通股（A 股） | | |
| 每股面值 | 人民币 1.00 元 | | |
| 发行股数 | 不超过 5,000 万股 | 占发行后总股本比例 | 不低于 10% |
| 其中：发行新股数量 | 不超过 5,000 万股 | 占发行后总股本比例 | 不低于 10% |
| 股东公开发售股份数量 | 本次发行不涉及老股转让 | 占发行后总股本比例 | - |
| 发行后总股本 | 不超过 41,000 万股 | | |
| 每股发行价格 | 【】元 通过向询价对象询价或符合中国证监会规定的其他方式确定发行价格 | | |
| 发行市盈率 | 【】倍（每股收益按【】年经审计的、扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算） | | |
| 发行前每股净资产 | 【】元（按经审计的截至【】年【】月【】日归属于母公司股东的净资产除以发行前总股本计算） | 发行前每股收益（元/股） | 【】 |
| 发行后每股净资产 | 【】元（按本次发行后归属于母公司股东的净资产除以发行后总股本计算，其中，发行后归属于母公司股东的净资产按经审计的截至【】年【】月【】日归属于母公司股东的净资产和本次募集资金净额之和计算） | 发行后每股收益（元/股） | 【】 |
| 发行市净率 | 【】倍（按每股发行价除以发行后每股净资产计算） | | |

| | |
|-------------|--|
| 发行方式 | 本次发行将采取网下向网下投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他发行方式 |
| 发行对象 | 符合资格的网下投资者和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（中国法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外）或中国证监会规定的其他对象 |
| 承销方式 | 主承销商余额包销 |
| 拟公开发售股份股东名称 | 无 |
| 发行费用的分摊原则 | 不适用 |
| 募集资金总额 | 【】 |
| 募集资金净额 | 【】 |
| 募集资金投资项目 | PCB 微型钻针生产基地建设项目 |
| | 精密刀具类产品扩产项目 |
| | 补充流动资金及偿还银行借款项目 |
| 发行费用概算 | 本次发行费用总额为【】万元，包括：保荐承销费【】万元，审计及验资费用【】万元，评估费用【】万元，律师费用【】万元，信息披露费用【】万元，股份登记费用【】万元，发行手续费用【】万元；其他费用【】万元 |

三、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况

中信证券指定万俊、曾劲松为鼎泰高科首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐代表人；指定姚泽广为本次发行的项目协办人；指定陈双双、王煦、陈立丰为项目组成员。

（一）保荐代表人

万俊先生：现任中信证券投资银行委员会副总裁，保荐代表人。负责或作为项目组主要成员参与了惠威科技 IPO、气派科技 IPO、皮阿诺非公开、证通电子非公开、日海智能非公开、金龙机电非公开、新乳业可转债、利尔化学可转债、新乳业重大资产重组、金龙机电重大资产重组、泰豪科技发行股份购买资产等项目。

曾劲松先生：现任中信证券投资银行委员会执行总经理，保荐代表人。2000 年加入中信证券投资银行部担任高级经理，2004 年加入华林证券投资银行部，担任部门副总经理；2006 年进入国信证券投资银行事业部，担任执行总经理。2014 年加入中信证券，目前担任中信证券投资银行委员会执行总经理。曾参与华源股份配股、广深铁路 IPO、万科可转债、中联重科大股东改制及收购浦沅机

械、腾邦国际产业并购等项目，负责并主持锡业股份可转债、岳阳纸业配股、梦洁家纺 IPO、腾邦国际 IPO、安奈儿 IPO、腾邦国际非公开、梦洁股份非公开、鄂武商非公开、日海智能非公开、歌力思非公开等项目，并担任洪涛股份 IPO、科士达 IPO、腾邦国际 IPO、安奈儿 IPO、汤臣倍健非公开、美的集团非公开、腾邦国际非公开、丸美股份 IPO、新乳业可转债、欢乐家 IPO 等项目的保荐代表人，具有丰富的企业改制重组、企业首次公开发行股票并上市、上市公司再融资及产业并购等证券从业经验。

（二）项目协办人

姚泽广先生：现任中信证券投资银行委员会高级经理，保荐代表人。曾就职于光大证券，2020 年加入中信证券，负责或作为主要项目组成员参与了爱贝科 IPO 项目、清远齐力 IPO 项目、百味佳 IPO 项目、南宁糖业定向增发项目，南糖产业基金收购英联糖业中国业务项目，具有扎实理论基础和丰富投行实践经验。

（三）项目组其他成员

陈双双先生：现任中信证券投资银行委员会高级副总裁。2014 年加入中信证券，负责或作为主要项目组成员参与了汤臣倍健非公开项目、招商地产可转债项目、力合微电子 IPO 项目、东方嘉盛 IPO 项目、珠江啤酒非公开项目、梦洁股份非公开项目、丸美股份 IPO 项目、汤臣倍健重大资产重组项目、歌力思非公开发行项目、恐龙园 IPO 项目、欢乐家 IPO 项目、瑞丰高材可转债项目等。

王煦女士：现任中信证券投资银行委员会高级经理，注册会计师。2019 年加入中信证券。王煦女士作为项目组核心成员先后参与了山东玉马遮阳科技股份有限公司 IPO 项目、深圳市星源材质科技股份有限公司可转债项目、上海纽恩特实业股份有限公司 IPO 项目。

陈立丰先生：现任中信证券投资银行委员会高级副总裁，保荐代表人，注册会计师。曾就职于毕马威华振会计师事务所深圳分所，期间参与并组织了中信集团整体上市、华昱高速、深圳华为等大型项目的审计工作，2012 年开始从事投资银行工作，先后参与并负责了鲁亿通、共进股份、志特新材、世强科技 IPO 项目，中海达、共进股份、比亚迪、格林美、中科电气非公开发行项目，中科电气重大资产重组项目、农产品重大资产出售项目。

四、保荐人与发行人的关联关系

（一）本保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有或者通过参与本次发行战略配售持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况

截至本上市保荐书签署日，本保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方未持有或者通过参与本次发行战略配售持有发行人或其控股股东、重要关联方股份。

（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有本保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份情况

截至本上市保荐书签署日，除可能存在少量、正常的二级市场证券投资外，发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方未持有本保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份。

（三）保荐人的保荐代表人及其配偶、董事、监事、高级管理人员，持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况

截至本上市保荐书签署日，本保荐人的保荐代表人及其配偶、董事、监事、高级管理人员不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况。

（四）保荐人控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况

截至本上市保荐书签署日，本保荐人控股股东、实际控制人、重要关联方不存在与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况。

（五）保荐人与发行人之间的其他关联关系

发行人股东金石坤享持有公司 356.40 万股股份，占发行人本次发行上市前总股本的 0.99%。金石坤享的普通合伙人及执行事务合伙人为金石沔纳投资管理（杭州）有限公司，金石坤享的基金管理人为青岛金石灏纳投资有限公司。金石沔纳投资管理（杭州）有限公司和青岛金石灏纳投资有限公司均系中信证券通过

全资子公司金石投资有限公司 100% 持股的子公司。

除上述情形外，截至本上市保荐书签署日，本保荐人与发行人之间不存在其他关联关系。

第二节 保荐人承诺事项

本保荐机构已按照法律法规和中国证监会及深圳证券交易所相关规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序，同意推荐发行人证券发行上市，并据此出具本上市保荐书及就下列事项做出承诺：

（一）有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定；

（二）有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

（三）有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

（四）有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

（五）保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

（六）保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（七）保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；

（八）自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施；

（九）中国证监会规定的其他事项。

若因本保荐机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本保荐机构将依法赔偿投资者损失。

第三节 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论

一、本次发行履行了必要的决策程序

（一）董事会决策程序

2021年2月28日召开的公司第一届董事会第三次会议，审议通过了本次发行的相关议案。

（二）股东大会决策程序

2021年3月16日召开的2021年第一次临时股东大会，审议通过了本次发行的相关议案。

综上，本保荐机构认为，发行人本次发行已就本次证券发行上市履行了《公司法》、《证券法》和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序，获得了必要的批准和授权，决策程序合法有效。

二、是否符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件

（一）发行人符合各项上市条件

鼎泰高科股票上市符合《中华人民共和国证券法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件：

- 1、本次发行后股本总额为41,000万元，不低于3,000万元；
- 2、公开发行的股份占鼎泰高科本次发行后股份总数的12.20%，公开发行股份的比例为10%以上；
- 3、鼎泰高科2019年、2020年的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润分别为7,119.32万元和15,648.79万元，累计净利润不低于5,000万元，市值及财务指标符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的标准。

本次股票发行申请尚需深圳证券交易所审核并由中国证监会作出同意注册决定。

（二）发行人所选择的具体上市标准

发行人满足《深圳证券交易所创业板股票上市规则》2.1.2 规定的上市标准中的“（一）最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000 万元”。

三、保荐机构结论

本保荐机构根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《证券公司从事股票发行主承销业务有关问题的指导意见》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《保荐人尽职调查工作准则》等法规的规定，由项目组对发行人进行了充分的尽职调查，由内核会议进行了集体评审，认为：发行人法人治理结构健全，经营运作规范；发行人主营业务突出，经营业绩优良，发展前景良好；本次发行募集资金投资项目经过了必要的核准，市场前景良好，其顺利实施，将预期能够产生较好的经济效益，有利于进一步促进发行人的发展；发行人具备了相关法律、法规规定的首次公开发行股票并在创业板上市的条件。因此，本保荐机构同意对发行人首次公开发行股票并在创业板上市予以保荐。

四、对公司持续督导期间的工作安排

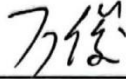
| 事项 | 工作安排 |
|--|---|
| （一）持续督导事项 | 在本次发行股票上市当年的剩余时间及其后 3 个完整会计年度内对发行人进行持续督导 |
| 1、督导发行人有效执行并完善防止大股东、实际控制人、其他关联机构违规占用发行人资源的制度 | 强化发行人严格执行中国证监会相关规定的意识，进一步完善各项管理制度和发行人的决策机制，协助发行人执行相关制度；通过《保荐及承销协议》约定确保保荐机构对发行人关联交易事项的知情权，与发行人建立经常性信息沟通机制，持续关注发行人相关制度的执行情况及履行信息披露义务的情况 |
| 2、督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度 | 督导发行人有效执行并进一步完善内部控制制度；与发行人建立经常性信息沟通机制，持续关注发行人相关制度的执行情况及履行信息披露义务的情况 |
| 3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见 | 督导发行人尽可能避免和减少关联交易，若有关的关联交易为发行人日常经营所必须或者无法避免，督导发行人按照《公司章程》、《关联交易决策制度》等规定执行，对重大的关联交易本机构将按照公平、独立的原则发表意见 |
| 4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国 | 与发行人建立经常性信息沟通机制，督促发行人负责信息披露的人员学习有关信息披露的规定 |

| 事项 | 工作安排 |
|--|--|
| 证监会、证券交易所提交的其他文件 | |
| 5、持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项 | 督导发行人按照《募集资金管理及使用制度》管理和使用募集资金；定期跟踪了解项目进展情况，通过列席发行人董事会、股东大会，对发行人募集资金项目的实施、变更发表意见 |
| 6、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见 | 督导发行人遵守《公司章程》、《对外担保制度》以及中国证监会关于对外担保行为的相关规定 |
| 7、持续关注发行人经营环境和业务状况、股权变动和管理状况、市场营销、核心技术以及财务状况 | 与发行人建立经常性信息沟通机制，及时获取发行人的相关信息 |
| 8、根据监管规定，在必要时对发行人进行现场检查 | 定期或者不定期对发行人进行回访，查阅所需的相关材料并进行实地专项检查 |
| (二)保荐协议对保荐机构的权利、履行持续督导职责的其他主要约定 | 有权要求发行人按照证券发行上市保荐有关规定和保荐协议约定的方式，及时通报与保荐工作相关的信息；在持续督导期间内，保荐机构有充分理由确信发行人可能存在违法违规行为以及其他不当行为的，督促发行人做出说明并限期纠正，情节严重的，向中国证监会、深圳证券交易所报告；按照中国证监会、深圳证券交易所信息披露规定，对发行人违法违规的事项发表公开声明 |
| (三)发行人和其他中介机构配合保荐机构履行保荐职责的相关约定 | 发行人及其高管人员以及为发行人本次发行与上市提供专业服务的各中介机构及其签名人员将全力支持、配合保荐机构履行保荐工作，为保荐机构的保荐工作提供必要的条件和便利，亦依照法律及其它监管规则的规定，承担相应的责任；保荐机构对发行人聘请的与本次发行与上市相关的中介机构及其签名人员所出具的专业意见存有疑义时，可以与该中介机构进行协商，并可要求其做出解释或者出具依据 |
| (四)其他安排 | 无 |

(以下无正文)

(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于广东鼎泰高科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书》之签字盖章页)

保荐代表人:

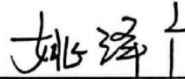


万俊



曾劲松

项目协办人:



姚泽广

内核负责人:



朱洁

保荐业务负责人:



马尧

董事长、法定代表人:



张佑君



中信证券股份有限公司 2022年3月1日